



## Agenda zur BMBF Auftaktveranstaltung

### „Technologien zur Systemintegration für zukünftige Elektroniksysteme" (TechSys)

**Ort:** Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - Berlin  
Konferenzsaal Alexander von Humboldt 2  
Kapelle-Ufer 1  
10117 Berlin

**Datum:** 12. Oktober 2017

09:00 - 09:30

#### **Registrierung**

09:30 – 10:00

#### **Begrüßung durch das BMBF**

10:00 – 10:55

#### **Session 1 – Leiterplattentechnologien – embedding**

PEKOS - Neue Prozesstechnologien zur Einbettung von Elektronikkomponenten in großflächige organische Substrate

*Dr. Andreas Ostmann – Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM*

ThermoFreq - Laserbasierte Technologieplattform zum Aufbau robuster Leistungselektroniksysteme

*Klaus Wilke - Siemens AG*

MODAL - Modularer Technologie-Baukasten für hochkompakte Elektroniksysteme auf Leiterplattenbasis

*Fabian Ganzer - Conti Temic microelectronic GmbH*

10:55 – 11:25

#### **Kaffeepause und Networking**

11:25 – 13:00

#### **Session 2 – Hybridintegration – HF-Elektronik**

TARANTO (aus der Förderinitiative ECSEL-JU) - Elektroniksysteme für Radar- und Kommunikationslösungen der nächsten Generation

*Dr. Wolfgang Dettmann – Infineon Technologies AG*

HyTeck - Hybridintegrationsplattform für zuverlässige Hochfrequenz-Schaltkreise

*Dr. Gerhard Kahmen - Rohde & Schwarz GmbH*

CoGaN - Neuartige Packaging-Technologie für Galliumnitrid basierte Hochfrequenz-Elektroniksysteme

*Dr. Klaus Riepe - United Monolithic Semiconductors GmbH*



	<p>HYPATIA - Hybride Packaging-Technologie für Innovative 300 GHz Radar Anwendungen <i>Dr. Christian Frank - Sikora AG</i></p> <p>MIIMOSYS - Technologien und Prozesse zur Heterointegration leistungselektronischer Systeme <i>Ralf Lerner – X-Fab Semiconductor Foundry AG</i></p>
13:00 – 14:00	<b>Mittagspause und Networking</b>
14:00 – 15:15	<p><b>Session 3 – Packaging-Technologien – Glas/Keramik</b></p> <p>FELAF (<i>aus der Förderinitiative KMU-innovativ</i>) - Faserverbundintegriertes Elektroniksystem zur langzeitzuverlässigen Füllstandsmessung <i>Oliver Weißenborn - Technische Universität Dresden</i></p> <p>GlaRa - Glasinterposer-Technologie zur Realisierung hochkompakter Elektroniksysteme für Hochfrequenzanwendungen <i>Dr. Malte Schulz-Ruhtenberg - LPKF Laser &amp; Electronics AG</i></p> <p>PRISMA - Integrationsplattform für mikromechanische und -optische Elektroniksysteme auf Basis funktioneller Glasgehäuse <i>Dr. Stefan Weinberger - X-Fab MEMS Foundry Itzehoe GmbH</i></p> <p>RobopS - Neue Gehäusetechnologien für optoelektronische Sensorsysteme <i>Franz Bechtold - Via electronic GmbH</i></p>
15:15 – 15:40	<b>Kaffeepause und Networking</b>
15:40 – 16:40	<p><b>Session 4 – Diverse Systemintegrationstechnologien</b></p> <p>HYB-Man - Hybrid additiv 3D-gefertigte smarte Elektroniksysteme <i>Bernhard Polzinger – Robert Bosch GmbH</i></p> <p>Texas - Baukasten für multifunktionale textiladaptierte Elektroniksysteme <i>Volkmar Reichmann - Textilforschungsinstitut Thüringen Vogtland e. V.</i></p> <p>ADAMOS - Systemintegrationstechnologien für multifunktionale folienbasierte Elektroniksysteme <i>Dr. Florian Grimminger - Infineon Technologies AG</i></p>
16:40 - 17:00	<b>Schlusswort und Diskussionsrunde</b>
17:00	<b>Ende der Veranstaltung</b>